**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE CONTACT**

Matt Burns

 matthew.burns@samtec.com

 812-944-6733

**[LOGO SAMTEC] Septembre 2017**

**Samtec** **étend son système ExaMAX® de connecteurs pour fond de panier haut débit** **avec ses nouvelles options DMO (Direct Mate Orthogonal)**

L’architecture orthogonale apporte une meilleure intégrité du signal et des gains de rendement thermique

**New Albany, Indiana :** Samtec, entreprise à capitaux privés qui réalise un chiffre d'affaires de 662 millions de dollars, et fabricant mondial d'une gamme étendue de solutions d'interconnexion pour l'industrie électronique, annonce l’extension de son système ExaMAX® de connecteurs pour fond de panier haut débit, avec de nouvelles options DMO. Les concepteurs de systèmes peuvent désormais tirer pleinement parti des avantages spécifiques des architectures orthogonales directes à comparer aux systèmes traditionnels de fonds de panier.

Les nouvelles solutions ExaMAX® DMO de Samtec apportent aux concepteurs de systèmes la flexibilité dont ils ont besoin en éliminant la nécessité d’un fond de panier intermédiaire (midplane), ce qui permet d’insérer directement les cartes réseau et les cartes de ligne. En plein développement, cette architecture système permet d’accroître le flux d’air et d’améliorer le rendement thermique de l’ensemble du châssis. Les solutions DMO améliorent l'intégrité du signal en réduisant la longueur des pistes et les transitions liées aux connecteurs. En outre, elles permettent de rationaliser les nomenclatures et d’optimiser les coûts des systèmes.

Le système ExaMAX® DMO de Samtec comprend la nouvelle série [EBDM-RA](https://www.samtec.com/products/ebdm-ra), qui peut se connecter directement à la série [EBTF-RA](https://www.samtec.com/products/ebtf-ra) existante. Les solutions proposées comprennent des ensembles 6 paires x 10 colonnes et 6 paires x 12 colonnes. Des broches de guidage et la visserie sont également proposées. Des options 6 paires x 6 colonnes et 6 paires x 8 colonnes sont en cours de développement.

« Les concepteurs de systèmes de nouvelle génération adoptent de plus en plus les architectures DMO », a déclaré Jonathan Sprigler, responsable des produits fonds de panier chez Samtec, Inc. « Les fournisseurs d’équipements les plus performants pour les centres de données (stockage, serveurs, réseaux et autres applications) capitalisent sur les atouts des solutions DMO grâce à la nouvelle série EBDM-RA de Samtec ».

La série [EBDM-RA](https://www.samtec.com/products/ebdm-ra) de Samtec n’est que l’une des solutions intégrées au système ExaMAX® de connecteurs haut débit pour fonds de panier. La gamme de produits ExaMAX® est optimisée pour des débits atteignant 56 Gbps (modulation PAM-4). La conformité concernant la perte en retour est assurée pour les deux versions de systèmes (85 Ω et 100 Ω) du fait de l’application des spécifications à 92 Ω et de la maîtrise des réflexions pour toutes les transitions géométriques à l’intérieur du connecteur.

La gamme ExaMAX® bénéficie également de la plus faible force d’insertion de l’industrie avec un excellent niveau de force normale. Elle est en outre conforme aux spécifications Telcordia GR-1217 CORE. Capables d’assurer deux points de contact fiables à tout moment, même en cas d'insertion sous un angle donné, les embouts résiduels sont limités au minimum pour une meilleure intégrité du signal. La zone de contact de 2,4 mm contribue à la fiabilité et l’interface hermaphrodite assure un couplage sans embout superflu et un alignement fiable.

Le système de fond de panier comporte des plaquettes de signal individuelles avec paires différentielles en quinconce, disposées en colonnes sans inclinaison. Chaque plaquette comporte une structure estampée de mise à la masse, d'une seule pièce, destinée à renforcer l’isolation pour réduire significativement la diaphonie.

Pour en savoir plus, accédez au webinaire « [High-Speed Backplane Connectors Drive 56 Gbps and Beyond](http://www.eejournal.com/chalk_talks/high-speed-backplane-connectors-drive-56-gbps-and-beyond/) », visitez la page d’accueil [ExaMAX® High-Speed Backplane Connector System](https://www.samtec.com/connectors/backplane/high-speed-backplane-systems/examax) ou téléchargez le document [High-Speed Board-to-Board Application Design Guide](http://suddendocs.samtec.com/literature/samtec-high-speed-b2b-design-guide.pdf). Vous pouvez immédiatement bénéficier d’une assistance technique grâce aux experts de Samtec, spécialistes des applications de fonds de panier, en envoyant un e-mail à l’adresse : HSBP@samtec.com.

**À propos de Samtec, Inc.**

Fondée en 1976, Samtec est une entreprise à capitaux privés qui réalise un chiffre d'affaires de 662 millions de dollars, et fabricant mondial d'une gamme étendue de solutions d'interconnexion pour l'industrie électronique ; notamment les dispositifs de connexion CI-carte et de conditionnement de CI, les systèmes mezzanine flexibles et haute vitesse, les composants optiques, les systèmes flexibles d'empilage de cartes, composants micro-pas et renforcés, et les ensembles de câbles. Les centres technologiques de Samtec se consacrent à développer et faire évoluer les technologies, les stratégies et les produits pour optimiser à la fois les performances et les coûts d'un système, depuis la puce élémentaire jusqu'à une interface située à 100 m de distance, en assurant tous les points d'interconnexion nécessaires entre l'une et l’autre. Avec 33 sites implantés dans 18 pays, la présence mondiale de Samtec lui permet d'assurer un service client inégalé. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.samtec.com>.

ExaMAX® est une marque déposée d’Amphenol Corporation.

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Téléphone : 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[www.samtec.com](http://www.samtec.com)